

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66015

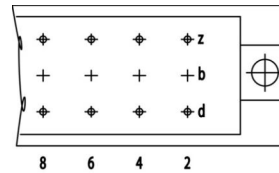
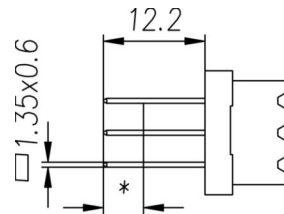


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Power



Rugged

- Anschlusslänge 12.2 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 32
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe DIN 41612

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66015



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	32
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	12.2 mm
Leiterplattenabstand	24.4 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Mechanisch

Rastermaß	5.08 x 3.81 mm
Steckkraft	< 50 N
Ziehkraft pro Kontakt	>0.2 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

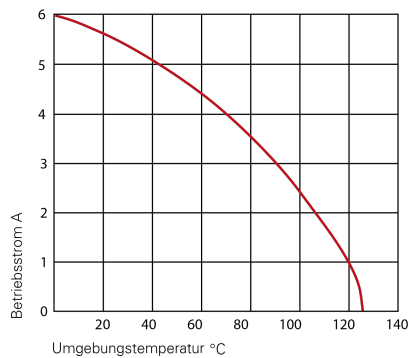
Elektrisch

Betriebsstrom	5.6 A
Durchgangswiderstand	< 15 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	K: ≥ 3.0 mm, L: ≥ 1.6 mm
Isolationswiderstand	> 10 ⁶ MΩ
Prüfspannung	1550 V

Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

Derating Diagramm

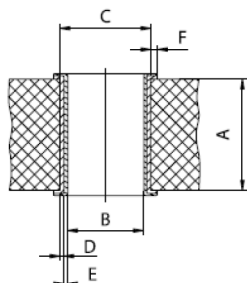


Bauform D, E, F, G

20 °C	5,6 A
70 °C	4,0 A
100 °C	2,5 A

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.75 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.75 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.75 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.75 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66015



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter sales@ept.de